

# 2024北京微电子国际研讨会暨 IC WORLD 大会

## 官方报名操作指南

2024年4月

# 目录

1.注册登录 .....	3
2.展商报名 .....	3
3.嘉宾报名 .....	7
4.其他 .....	13

## 1.注册登录

点击“个人中心”或“嘉宾报名”或“展商报名”时，需要先登录系统，如果没有账号，需要点击“立即注册”按钮，注册账号。也可点击“验证码登录”按钮，用手机短信验证码登录。



## 2.展商报名

(1) 点击首页banner图、点击首页“申请参展”按钮，进行展会报名。





(2) 登录系统，如果没有注册，点击“立即注册”按钮，进行注册。也可点击“验证码登录”按钮，用手机验证码登录。



(3) 登录后，完善信息，填写完成后点击“下一步”



(4) 选择展位及价格，选择完成后，点击“下一步”即可。

- 

填写信息
- 

选择展位  
及价格
- 

生成并确认  
合同
- 

完成  
展位选择
- 

提交参会  
人员信息

场馆: \*

- A展馆
- B2展馆

展位分区: 制造-设备区

未选择:  未选择:  您选择:  注: 展位信息横向滚动查看



您已选择的展位: A-T01 ×

展位价格总计: **162,000.00** 元

注: 若对价格有疑问可随时联系组委会。

上一步 (Back)

下一步 (Next)

(5) 点击“浏览合同”按钮，查看合同，如果合同有误，选择“合同有误或需法审”上传修改后的合同，如果取消展位点击“取消展位”按钮，合同确认后，点击“下一步”。

填写信息 — 选择展位及价格 — 生成并确认合同 — 完成展位选择 — 提交参会人员信息

✔ 展位已经锁定，锁定日期为：2024-04-23，请于锁定日起10日内核对并签订合同。

[预览合同 \(Preview Contract\)](#)

合同无误 (without Error)  
 合同有误或需法务审核 (Error or review)  
 展位取消 (Cancellation)

注：组委会将在5个工作日内将盖章版合同发予展商，请展商回传。

[上一步 \(Back\)](#) [下一步 \(Next\)](#)

(6) 填写参会人员信息，如果添加多人，点击“添加新人员信息”按钮，添加信息。

填写信息 — 选择展位及价格 — 生成并确认合同 — 完成展位选择 — 提交参会人员信息

✔

已收到您提交的展位合同，感谢您的参与！

请您对接主场公司，展商手册可于【[资料下载](#)】页面自行下载。

还请您在**布展开始前**提交参会人员信息

[提交参会人员信息 \(Participant Information\)](#) [查看报名信息 \(Registration Information\)](#)

提醒：上传资料后，组委会将于大会布展开始的三天前向您发送参展确认函，届时请您留意邮箱。



\* 参展人数 (Number People) : 1

\* 姓名 (Name) :  \* 职位 (Post) :

\* 证件类型 (ID Type) :  \* 证件号码 (ID Number) :

\* 居住地址 (Address) :  \* 公司名称 (Unit Name) :

\* 手机号 (Tel) :

(7) 填写完成后，展商报名成功，在个人中心的我的展商报名中，可查看到报名信息，点击“查看详细”按钮，查看详细信息，点击“修改参会人”按钮，修改参会人员信息。

我的展商报名 >

我的展商报名

我的嘉宾报名 >

2024北京微电子国际研讨会暨IC WORLD大会

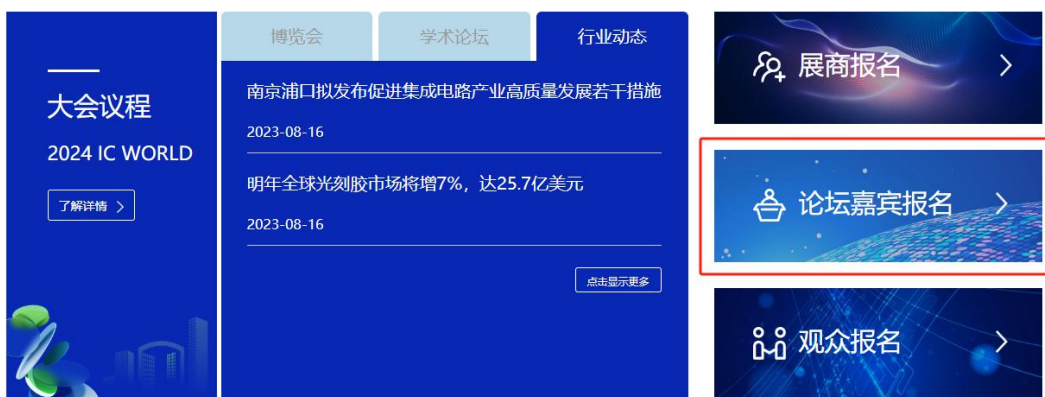
展位: A-T01

报名时间: 2024-04-23

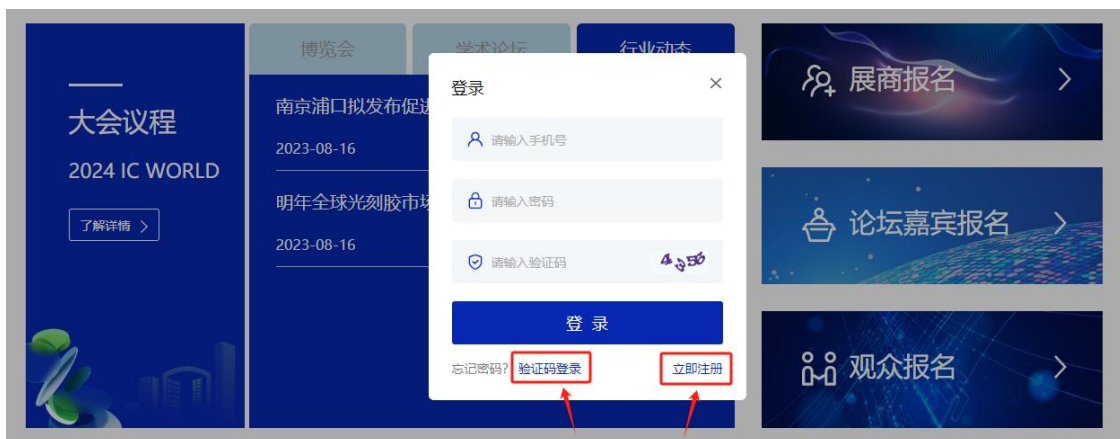
状态: 报名完成

### 3. 嘉宾报名

(1) 点击首页 banner图、点击首页“论坛嘉宾报名”按钮，进行嘉宾报名。



(2) 登录系统，如果没有注册，点击“立即注册”按钮，进行注册。也可点击“验证码登录”按钮，用手机验证码登录。



(3) 登录后，选择报名方式





## 方式一：企业嘉宾

① 填写信息，填写完成后点击“下一步”



填写信息 (Speech Information)

* 演讲题目 (Speech Topic) :	* 单位名称 (Unit Name) :
<input type="text"/>	<input type="text"/>
* 演讲嘉宾姓名 (Name) :	* 职位 (Post) :
<input type="text"/>	<input type="text"/>
* 移动电话 (Tel) :	* 邮箱 (Mailbox) :
<input type="text"/>	<input type="text"/>

② 报告上传，上传报告和稿件后点击“提交”按钮，等待组委会进行审核。



报告上传 (Report Upload) :

注：仅支持上传PPT文件，并按照【大会统一规格】格式，命名方式为“单位名称-演讲题目-演讲人姓名”。

稿件上传 (Manuscript Upload) :

注：如有与演讲内容相关的文字稿件，可一并上传，方便组委会审核。

上一步 (Back)    提交 (Submit)

③ 等待组委会进行审核时，您可以点击“查看报名信息”按钮，查看报名信息内容。



您的演讲PPT已提交，请等待审核...

[查看报名信息 \(Registration information\)](#)

④ 协议签订，审核通过后，填写嘉宾信息后，点击“下一步”按钮。



注：因演讲内容将在会后进行文稿汇编并整理出书，供政府、业内人士、专家学者等参阅，为保障双方权益，现特邀请您进行文稿协议签订，感谢您的配合。

#### 嘉宾信息 (Guest Information)

* 姓名 (Name): 张三	* 演讲题目 (Speech Topic): 测试5
* 电话 (Tel): 13366641003	* 邮箱 (Mailbox): 123@qq.com
* 身份证号码 (ID Number): 请输入身份证号码	

[下一步 \(Next\)](#)

⑤ 点击“预览协议”按钮，查看协议，协议无误，上传签名后，点击“提交”按钮，即可完成报名；如果协议有误，选择“协议需要修改”上传修改后的协议，协议确认无误后，点击“提交”按钮，即可完成报名。



文档协议已生成，生成日期为2024-04-23，请于生成日起5日内核对协议。

[预览协议 \(Preview Agreement\)](#)

协议无误 (without Error)  
 协议需要修改 (Error)

上传电子签名 (Upload Signature):

[上传签名 \(Upload\)](#)

注：  
1. 签署者将在论坛当天将签署后协议发予嘉宾本人。  
2. 请上传200px\*80px的签名图片，如下图：

张三

⑥ 上传完成后，点击“查看报名信息”按钮，查看报名内容。



⑦ 嘉宾可在个人中心的“我的嘉宾报名”中，点击“添加”按钮，添加新信息，点击“信息查看”按钮，查看信息，点击“进度查看”按钮，查看报名进度。



## 方式二：高校/科研院所嘉宾

① 填写信息，填写完成后点击“下一步”。



② 报告上传，上传报告和稿件后点击“下一步”。



报告上传 (Report Upload) :

注: 仅支持上传PPT文件, 并按照【大会统一模版】修改, 命名方式为“单位名称-演讲题目-演讲人姓名”。

[上传报告 \(Upload\)](#)

稿件上传 (Manuscript Upload) :

注: 如有与演讲内容相关的文字稿件, 可一并上传。

[上传稿件 \(Upload\)](#)

[上一步 \(Back\)](#) [下一步 \(Next\)](#)

③ 协议签订，填写嘉宾信息和专家费信息后，点击“下一步”按钮。

2024 北京微电子国际研讨会  
Beijing International Seminar on Micro-Electronics  
第 IC W @RLD 大会  
21C WORLD CONFERENCE

首页 大会概况 博览会 学术论坛 历届回顾 赞助机会 联系我们 资料下载

中文 EN 个人中心

### 嘉宾报名

完善信息 稿件上传 协议签订 生成并确认协议 完成

注：因演讲内容将在会后进行文集汇编并出版，供政府、业内人士、专家学者等参阅，为保障双方权益，请特邀嘉宾进行文集协议签订，感谢您的配合。

**嘉宾信息 (Guest Information)**

\* 姓名 (Name) : 张柱 \* 演讲题目 (Speech Topic) : 赛题5

\* 电话 (Tel) : 13366641003 \* 邮箱 (Mailbox) : 123@qq.com

\* 身份证号码 (ID Number) : 请输入身份证号码

**专家费信息 (Expert Fee Information)**

\* 银行卡号 (Bank card number) : 请输入银行卡号 \* 开户行 (Bank) : 请输入开户行

④ 点击“预览协议”按钮，查看协议，协议无误，上传签名后，点击“提交”按钮，即可完成报名；如果协议有误，选择“协议需要修改”上传修改后的协议，协议确认无误后，点击“提交”按钮，即可完成报名。

2024 北京微电子国际研讨会  
Beijing International Seminar on Micro-Electronics  
第 IC W @RLD 大会  
21C WORLD CONFERENCE

首页 大会概况 博览会 学术论坛 历届回顾 赞助机会 联系我们 资料下载

中文 EN 个人中心

### 嘉宾报名

完善信息 稿件上传 协议签订 生成并确认协议 完成

文集协议已生成，生成日期为2024-04-23，请于生成日起5日内核对协议。

预览协议 (Preview Agreement)

协议无误 (without Error)  
 协议需要修改 (Error)

上传电子签名 (Upload Signature) :

上传签名 (Upload)

注：  
1. 组委会将在会后当天将嘉宾演讲内容汇编成册，供政府、业内人士、专家学者等参阅，为保障双方权益，请特邀嘉宾进行文集协议签订，感谢您的配合。  
2. 请上传宽200px高80px的签名图片，如下图：

张三

⑤ 上传完成后，点击“查看报名信息”按钮，查看报名内容。



⑥ 嘉宾可在个人中心的“我的嘉宾报名”中，点击“添加”按钮，添加新信息，点击“信息查看”按钮，查看信息，点击“进度查看”按钮，查看报名进度。



## 4.其他

(1) 资料下载：点击“资料下载”按钮，可以下载大会的相关资料，如大会推广手册、展商手册、大会 PPT模板等。





## 资料下载

大会-LOGO

立即下载

大会-官网操作指南

立即下载

博览会-市场推广手册

立即下载

博览会-展品报备单

立即下载